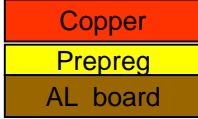


CY-AL-P01

铝基覆铜板性能表

Item	Unit		Specification
Insulation thickness (绝缘厚度)	μm	Min	75
Solder resistance (288deg.c (热冲击))	Sec.	Min	120
Peel strength normal status (剥离强度)	Lb / in	Min	15
Volume resistivity normal status (体积电阻率)	$\text{M}\Omega\cdot\text{CM}$		10^7
Surface resistivity normal status (表面电阻率)	$\text{M}\Omega$		10^6
Dielectric constant 1 MHz normal status (介电常数)			4.2
Dissipation Factor 1 MHz normal status (介质损耗角)			0.023
CTI	V		600
Water absorption (吸水率)	%		0.1
Breakdown Voltage(破坏电压)	KV		DC4 KV
Thermal conductivity (导热系数) (Measured on insulation layer only)	W / m.K		0.5-0.8
Flameability(燃烧性)	UL94V-0		Pass

铝基板厚度、尺寸

产品类别	CY-AL-P01				
产品结构					
尺寸 mm	500*600mm 500*1200mm 600*1200mm				
常用厚度(mm)	2.0 1OZ	1.5 1OZ	1.5 2OZ	1.0 1OZ	0.8 1OZ
备注	以上铝基合金板均经过特殊处理，可彻底避免起泡分层缺陷。				

- 以上的厚度不含胶厚及铜箔厚度，且铜箔厚与铝板厚可任意组合。
铜箔厚：H oz ~ 5.0 oz，铝板厚：0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、3.2mm (公差范围 $\pm 0.10\text{mm}$)
- 功率混合IC(HIC)
- 音频设备:输入,输出放大器,平衡放大器,音频放大器,前置放大器,功率放大器等.
- 电源设备:系列稳压器、开关调节器、DC-AC转换器等 .
- 通讯电子设备:高频增幅器,滤波电路,发报电路.
- 办公自动化 :打印机驱动器、大电子显示器基材、热打印头等.
- 汽车 :点火器、电源调节器、交流变换器、电源控制器、变光系统等 .
- 计算机:CPU板、软盘驱动器、电源装置等.
- 功率模块:换流器,固体继电器,整流电桥等.
- LED照明:大功率LED灯,LED墙等.

CY-AL-A02

铝基覆铜板性能表

Item	Unit		Specification
Insulation thickness (绝缘厚度)	μ m	Min	100
Solder resistance (288deg.c (热冲击))	Sec.	Min	120
Peel strength normal status (剥离强度)	Lb / in	Min	15
Volume resistivity normal status (体积电阻率)	M Ω .CM		10 ⁷
Surface resistivity normal status (表面电阻率)	M Ω		10 ⁶
Dielectric constant 1 MHz normal status (介电常数)			4.9
Dissipation Factor 1 MHz normal status (介质损耗角)			0.023
CTI	V		480
Water absorption (吸水率)	%		0.1
Breakdown Voltage(破坏电压)	KV		DC4 KV
Thermal conductivity (导热系数) (Measured on insulation layer only)	W / m.K		1.2-1.5
Flameability(燃烧性)	UL94V-0		Pass

铝基板厚度、尺寸

产品别	CY-AL-A02							
产品结构	<table border="1"><tr><td>Copper</td></tr><tr><td>ZD-preg</td></tr><tr><td>AL board</td></tr></table>					Copper	ZD-preg	AL board
Copper								
ZD-preg								
AL board								
尺寸 inch	500*600mm/500*1200mm/600*1200mm							
常用厚度	2.0 10Z	1.5 10Z	1.5 20Z	1.0 10Z	0.8 10Z			
备注	以上铝基合金板均经过特殊处理，可彻底避免起泡分层缺陷。							

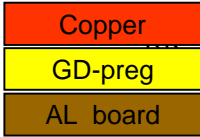
- 以上的厚度不含胶厚及铜箔厚度，且铜箔厚与铝板厚可任意组合。
铜箔厚：H oz ~ 5.0 oz，铝板厚：0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、3.2mm (公差范围 \pm 0.10mm)
- 符合RoHS规格

CY-AL-B03

铝基覆铜板性能表

Item	Unit		Specification
Insulation thickness (绝缘厚度)	μm	Min	100
Solder resistance (288deg.c (热冲击))	Sec.	Min	120
Peel strength normal status (剥离强度)	Lb / in	Min	15
Volume resistivity normal status (体积电阻率)	$M\Omega \cdot\text{CM}$		10^7
Surface resistivity normal status (表面电阻率)	$M\Omega$		10^6
Dielectric constant 1 MHz normal status (介电常数)			4.9
Dissipation Factor 1 MHz normal status (介质损耗角)			0.023
CTI	V		480
Water absorption (吸水率)	%		0.1
Breakdown Voltage(破坏电压)	KV		DC4 KV
Thermal conductivity (导热系数) (Measured on insulation layer only)	W / m.K		1.8-2.0
Flameability(燃烧性)	UL94V-0		Pass

铝基板厚度、尺寸

产品别	CY-AL-B03				
产品结构					
尺寸 MM	500MM*600mm/500*1200mm				
常用厚度	2.0 10Z	1.5 10Z	1.5 20Z	1.0 10Z	0.8 10Z
备注	以上铝基合金板均经过特殊处理，可彻底避免起泡分层缺陷。				

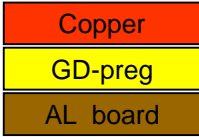
- 以上的厚度不含胶厚及铜箔厚度，且铜箔厚与铝板厚可任意组合。
铜箔厚：H oz ~ 5.0 oz，铝板厚：0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、3.2mm (公差范围±0.1mm)
- 符合RoHS规格

CY-AL-C04

铝合金板性能表

Item	Unit		Specification
Insulation thickness (绝缘厚度)	μm	Min	100
Solder resistance (288deg.c (热冲击))	Sec.	Min	120
Peel strength normal status (剥离强度)	Lb / in	Min	15
Volume resistivity normal status (体积电阻率)	$\text{M}\Omega\cdot\text{CM}$		10^7
Surface resistivity normal status (表面电阻率)	$\text{M}\Omega$		10^6
Dielectric constant 1 MHz normal status (介电常数)			4.9
Dissipation Factor 1 MHz normal status (介质损耗角)			0.023
CTI	V		480
Water absorption (吸水率)	%		0.1
Breakdown Voltage(破坏电压)	KV		DC4 KV
Thermal conductivity (导热系数) (Measured on insulation layer only)	W / m.K		2.7-3.0
Flameability(燃烧性)	UL94V-0		Pass

铝基板厚度、尺寸

产品别	CY-AL-C04				
产品结构					
尺寸 inch	500*1200mm/500*600mm				
常用厚度	2.0 10Z	1.5 10Z	1.5 20Z	1.0 10Z	0.8 10Z
备注	以上铝基合金板均经过特殊处理，可彻底避免起泡分层缺陷。				

- 以上的厚度不含胶厚及铜箔厚度，且铜箔厚与铝板厚可任意组合。
铜箔厚：H oz ~ 5.0 oz，铝板厚：0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、3.2mm (公差范围 $\pm 0.1\text{mm}$)
- 符合RoHS规格